

KOSDAQ | 반도체와반도체장비

싸이닉솔루션 (234030)

꾸준히 성장하는 시스템 반도체 디자인하우스

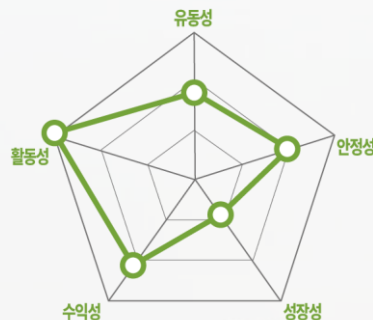
체크포인트

- 싸이닉솔루션은 2005년 SK하이닉스 출신 인력들이 설립한 시스템 반도체 생태계 內 디자인솔루션파트너(DSP) 기업. 당사는 2025년 7월에 상장. PMIC, CIS 제품 관련 시스템 반도체 디자인하우스로서 안정적 실적을 시현 중인 강소기업
- 투자포인트는 1) 신성장동력 신제품(센서 3종)을 통한 중장기적 성장 기대, 2) 現 주력 제품(PMIC, CIS)의 안정적인 성장
- 리스크 요인은 DSP 업계의 전반적으로 낮은 수익성
- 싸이닉솔루션은 현재 2026F PER 18.1배로 거래되는 중. PMIC·CIS의 안정적인 성장과 준비 중인 신제품 센서 3종의 고객 확보 및 양산 일정 이 구체적으로 확인된다면 최근 주가 약세를 딛고 동사에 대한 시장 관심도는 상승 가능할 것으로 기대

주가 및 주요이벤트



재무지표



주: 2025년 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 등급화

밸류에이션 지표



주: PSR, PBR은 2025년 기준, PBR은 1Q26 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가

싸이닉솔루션 (234030)

Analyst 백종석 jongsukbaek@kirs.or.kr

RA 김지은 jekim0216@kirs.or.kr

KOSDAQ

반도체와반도체장비

싸이닉솔루션은 중화권 고객을 주요 고객으로 가진 디자인솔루션파트너 기업

동사는 주로 중국, 대만 지역 팹리스 고객들을 확보한 시스템 반도체 관련 디자인하우스. 2025년 연간 연결 기준 제품별 매출비중은 ASIC-PMIC(Power Management Integrated Circuit) 53.6%, ASIC-CIS(CMOS Image Sensor) 22.7%, ASIC-DDI(Display Drive IC) 9.9%, ASIC-기타 5.1%, ASSP(Application Specific Standard Product) 0.5%, 개발용역 외 7.8%, 디스플레이 0.1%, 기타 0.5%

디자인하우스는 시스템 반도체 생태계 內 팹리스-파운드리 간 가교 역할 담당

디자인하우스는 시스템 반도체 팹리스 기업이 설계한 반도체를 특정 파운드리 공정에서 제조할 수 있는 형태로 구현하고 양산까지 관리하는 사업자로서, 시스템 반도체 산업에서 설계와 제조가 분리되는 과정에서 형성. 디자인하우스는 고객 상황/니즈에 따라 산업 내에서 기존 대비 더욱 넓은 범위로 사업을 담당하기도 하는 상황. 맞춤형 ASIC 수요와 설계 외주 범위가 확대되며 글로벌 ASIC 디자인서비스 시장은 2026년 189억 달러에서 2033년 307억 달러로 연평균 7.2% 성장할 것으로 전망됨

2026년, 매출액 위주로 성장세 예상. 중장기적으로 신제품 효과 기대

2026년 싸이닉솔루션 매출액, 영업이익은 각각 1,893억 원(+22.5% YoY), 21억 원(-15.9% YoY)을 전망. 제품 개발 확대 등으로 인해 단기적으로 이익보다 매출액 위주 성장이 도드라질 것으로 예상됨. 신제품 센서 3종이 본격적으로 매출에 기여할 예상 시점인 2028년 이후에는 규모의 경제 효과와 개발비 감소 가능성 등으로 인해 의미 있는 매출 성장과 수익성 개선을 기대

Forecast earnings & Valuation

	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액(억원)	N/A	1,382	1,674	1,546	1,893
YoY(%)	N/A	N/A	21.1	-7.7	22.5
영업이익(억원)	N/A	49	53	25	21
OP 마진(%)	N/A	3.5	3.1	1.6	1.1
지배주주순이익(억원)	N/A	16	55	17	40
EPS(원)	N/A	96	277	79	170
YoY(%)	N/A	N/A	187.7	-71.4	114.8
PER(배)	N/A	N/A	N/A	111.9	18.1
PSR(배)	N/A	N/A	N/A	1.2	0.4
EV/EBITDA(배)	N/A	N/A	N/A	66.5	16.1
PBR(배)	N/A	N/A	N/A	5.7	1.8
ROE(%)	N/A	12.5	34.7	6.2	10.4
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0

자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

Company Data

현재가(08/26)	3,075원
52주 최고가	12,030원
52주 최저가	2,430원
KOSDAQ(08/26)	82687p
자본금	24억원
시가총액	726억원
액면가	100원
발행주식수	24백만주
평균거래량(60일)	10만주
평균거래대금(60일)	4억원
외국인지분율	4.53%
주요주주	이현 외 2인 43.09%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	07	-67.1	-61.0
상대주가	-89	-52.8	-62.2

참고

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '0자보상배율', 성장성 지표는 '매출액 증가율', 수익성 지표는 'ROIC', 활동성 지표는 '총자산회전율', 유동성 지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군 내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.



기업 개요

싸이닉솔루션은 2005년 설립된 시스템 반도체 디자인하우스

**2005년 SK하이닉스 출신
인력들이 설립한 시스템 반도체
디자인솔루션파트너(DSP)**

싸이닉솔루션은 시스템 반도체 설계 노하우와 다양한 파운드리 공정 경험을 바탕으로 글로벌 팹리스 고객에게 최적의 디자인 솔루션 및 파운드리 서비스를 제공하는 DSP(디자인솔루션파트너)이다.

싸이닉솔루션은 2005년 설립되었다. 이현 대표 및 송창우, 김수희, 권성준 상무 등 舊 현대전자(現 SK하이닉스) 출신 인력들이 창업의 주축이었다. 창업 초기인 2005년 미국 Global Foundries와 디자인센터 협약을, 2006년 일본 SEIKO NPC와 디자인센터 협약을 맺었다. 2008년 산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 설립을 인증받았고, 당시 에스엘인베스트먼트로부터 약 6억 원 규모의 투자 유치를 받기도 했다. 2009년에는 매그나칩 반도체로부터 전문 디자인하우스로 지정을 받았다.

2013년경부터 싸이닉솔루션은 국내를 넘어 글로벌 진출을 본격화했다. 그 계기는 SK하이닉스와 파운드리 특판점 계약을 체결한 것이었고, 이를 통해 대만, 중국 시장으로 진출하였다. 이때부터 대만 폭스콘 등 규모가 큰 해외 IT 및 팹리스 기업들과 거래를 시작하며 성장했다. 즉 파운드리 기업인 SK하이닉스 시스템 사업부와 함께 디스플레이 IC, 이미지센서, 파워 IC 제품 관련하여 중화권 팹리스 고객들을 폭넓게 확보하였다.

2017년과 2019년 각각 일천만불, 이천만불 수출의 탑을 수상하기도 하였다. 2020년 싸이닉솔루션은 중국 사업의 확대 등을 위해 상해지사와 심천 자회사를 설립했다. 2021년에는 오천만불 수출의 탑을 수상하는 등 성장세를 이어나갔다. 2024년 동사는 중국 지역 사업을 강화하고자 상해 자회사를 설립했고, 일본 시스템 반도체 기업인 RENESAS로부터 IDH(Independent Design House) 기업으로 선정되기도 했다.

2025년 1월 코스닥 상장예비심사 청구서를 제출했고, 6월에 코스닥 시장 상장 공모를 위한 증권신고서를 제출하였으며, 2025년 7월 코스닥 시장에 상장했다.

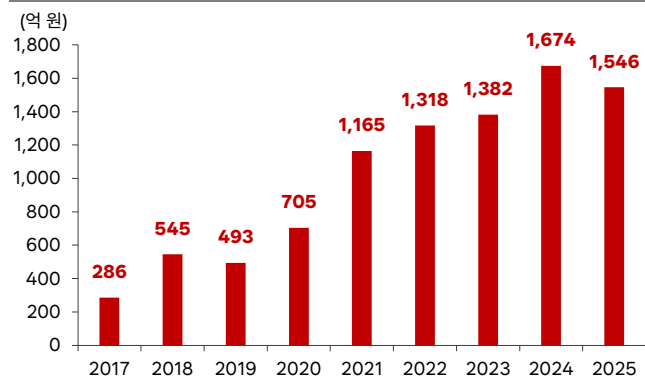
싸이닉솔루션의 연도별 실적 추이를 살펴보면 다음과 같다(아래 그래프 참조). 2017년 동사 매출액, 영업이익은 각각 286억 원, -5억 원을 기록했으나, 이듬해인 2018년 매출액 545억 원(+90.5% YoY)과 영업이익 6억 원(흑자전환 YoY)을 기록하며 처음 연매출액 500억 원을 돌파하는 고성장세를 보였다. 영업이익도 흑자로 전환했다.

2021년은 연매출액 1,000억 원 이상을 기록한 원년이었다. 2021년 싸이닉솔루션 매출액, 영업이익은 각각 1,165억 원, 30억 원이었다. 이후 2022년, 2023년 1,300억 원대 매출액을 기록하다 2024년에는 연매출액 1,674억 원을 달성하며 견조한 실적 성장세를 보였다.

실적 성장 측면에서 동사는 꾸준한 모습을 보였다. 매출액 성장세는 물론 특히 영업이익 측면에서 싸이닉솔루션은 2018년부터 매년 흑자 추세를 기록해 온 점이 인상적이다. 영업이익 흑자와 적자를 반복하는 경향이 있는 국내 여타 시스템 반도체 디자인하우스(상장사) 대비 동사는 양호한 수익성을 보이고 있어 이는 긍정적이라 평할 수 있다. 향후 기존 주력 제품인 PMIC(Power Management Integrated Circuit), CIS(CMOS Image Sensor) 외에 각종 신제품(멤스 마이크로폰 센서 등)들을 계획대로 2H27경부터 판매해 나간다면 싸이닉솔루션 성장성은 향후 더욱 향상될 수 있

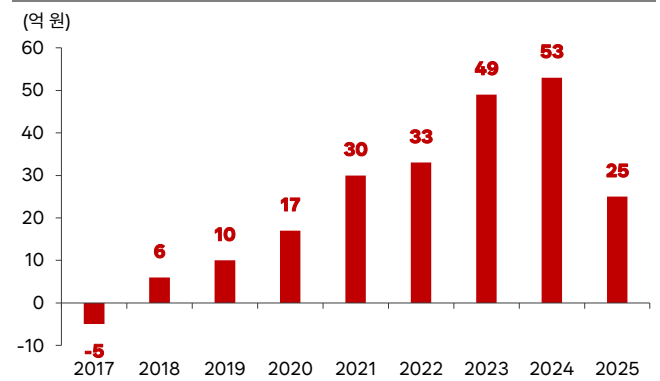
을 것으로 기대된다.

싸이닉솔루션 연결 기준 매출액 추이



자료: 싸이닉솔루션, 한국IR협회의 기업리서치센터

싸이닉솔루션 연결 기준 영업이익 추이



자료: 싸이닉솔루션, 한국IR협회의 기업리서치센터

중국 심천-상해에 지분 100%의 해외 종속기업 2개사 보유

싸이닉솔루션은 연결대상 종속기업으로 총 2개사를 보유하고 있다. Interhub Technology China(동사 지분율 100.0%, 2025년 말 기준 자산총액 289.9억 원)는 중국 심천 법인으로, 2019년 9월에 설립되었다. MK Technology Co., Ltd(동사 지분율 100.0%, 2025년 말 기준 자산총액 12.6억 원)는 중국 상해 법인으로, 2024년 3월에 설립되었다. 양 해외 법인 모두 반도체 설계, 해외 영업, 각종 현지 고객 대응 등 관련한 사업을 영위하고 있다.

매출의 구성, 주요 제품/서비스

팹리스와 파운드리를 잇는 DSP로 설계 최적화부터 양산 대행까지 수행

싸이닉솔루션은 시스템 반도체 산업 내 DSP(디자인솔루션파트너) 전문기업이다. DSP는 디자인하우스라고도 불린다. DSP는 팹리스(Fabless, 전공정 설계 전문기업) 기업과 파운드리(Foundry, 위탁생산 전문기업) 기업 사이에서 가교(架橋) 역할을 담당한다. DSP는 각 파운드리 기업의 공정 특성에 맞게 팹리스 고객의 전공정 설계를 최적화하고, 필요 IP(지적재산권)를 확보하며, 후공정 관련 전반적인 설계 및 진행 등도 담당한다. 또한, 주력 파운드리 기업에 대한 이해도가 높기에 특정 파운드리 기업에 대한 영업과 기술 지원 등을 담당하기도 한다.

다품종 소량생산이 일반적인 시스템 반도체 산업 생태계 내에서 DSP는 중심적인 역할을 담당하며, 그 역할 및 중요도가 꾸준히 확대되고 있다. 싸이닉솔루션은 파운드리 기업인 SK하이닉스시스템C의 유일한 DSP이고, 파운드리 기업 SK키파운드리의 주요 DSP이다.

2025년 매출은 ASIC-PMIC 53.6%, CIS 22.7%, DDI 9.9% 등으로 구성

2025년 연간 연결 기준 제품별 매출비중은 다음과 같다. ASIC-PMIC(Power Management Integrated Circuit) 53.6%, ASIC-CIS(CMOS Image Sensor) 22.7%, ASIC-DDI(Display Drive IC) 9.9%, ASIC-기타 5.1%, ASSP(Application Specific Standard Product) 0.5%, 개발용역 외 7.8%, 디스플레이 0.1%, 기타 0.5%이다.

디자인하우스의 경우 매출은 성격에 따라 개발과 양산이라는 2단계 과정을 거치며 발생하게 된다. 일반적으로 팹리스 회사들은 파운드리의 특정 공정에서 시제품 개발을 진행하여 칩을 검증하고, 이후 제품 양산에 이르게 되는데 이러한 과정을 대행하는 디자인하우스는 칩 개발 단계에서 개발(디자인서비스) 매출이 발생을 하고, 이후 양산에 돌입을 하게 되면 제품 매출이 발생하게 된다.

개발(디자인서비스) 매출의 세부 항목은 IP 라이선스, Back-end 설계 서비스, 포토마스크 제작, 시제품 웨이퍼 제조, 테스트 및 패키지 제작 등으로 구성되는데, 고객사에 따라 이 중 일부 또는 전부에 대한 서비스를 제공하며 매출이 발생하게 된다. 제품이 양산에 이르게 되면 디자인하우스는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit) 매출로 매출 인식을 하게 되는데, 디자인하우스 입장에서 칩 양산을 의뢰한 특정 팹리스 고객사에게만 납품이 가능한 범용성이 없는 칩 매출이기 때문에 이러한 명칭으로 매출 인식을 하고 있다.

45nm 이상 레거시 8인치 공정 기반의 맞춤형 ASIC이 주력 제품

싸이닉솔루션은 다양한 팹리스 고객들에게 맞춤형으로 파운드리 서비스를 제공하며, 레거시 공정(45nm 이상, 8인치 웨이퍼 중심)을 기반으로 다양한 반도체 칩을 공급하고 있다. 주력 제품은 PMIC(Power Management IC)와 CIS(CMOS Image Sensor)이다. 참고로 동사 ASIC 매출의 제품별 적용 분야는 아래와 같다. 싸이닉솔루션은 고객사별 요구에 따라 설계, 공정 선택, 생산 계획 등 토털 솔루션을 고객에게 제공하고 있다.

제품별 적용 분야

제품 구분	적용 분야
PMIC 반도체	모바일 스마트폰(Mobile Smartphone), LCD Display, 노트북, 태블릿, OLED TV 등
CIS 반도체	보안카메라, 보안인식용 카메라, IOT, 로봇, MACHINE VISION, Mobile/IT 기기 및 차량용 등
HV 반도체	LCD Display, LCD TV, 노트북(Laptop), USB Switch, Power Bank, Wireless Charger, Automotive 등
기타	MCU, Touch solution, Sensor ROIC, MEMS

자료: 싸이닉솔루션, 한국IR협회의 기업리서치센터

ASSP와 수수료·상품 매출은 규모는 작으나 꾸준히 발생

한편, 제품 기획 단계부터 개발 협력사와 공동으로 개발하여 부품 및 세트 메이커들에 대해 판매 수익을 공유하는 제품을 ASSP(Application Specific Standard Product)라고 하는데, 이러한 ASSP 매출은 크지는 않지만 꾸준히 이루어지고 있다. 동사의 경우 IR receiver IC와 Payment IC는 일반적인 제품과 달리 다수의 세트 제조사에게 판매를 할 수 있어 ASSP 매출로 분류하고 있다.

기타 매출에는 수수료 매출, 상품 매출 등이 있다. 수수료 매출은 동사가 판매 대행을 하고 있는 IP회사와 Raw 웨이퍼 제조사로부터 받는 판매 수수료이고, 상품 매출은 국내 팹리스 회사의 제품을 중국에 판매하며 발생하는 매출이다.

주 고객은 중화권 팹리스 고객사들

2025년 기준 220여 개 팹리스 고객 확보, 중화권 비중이 높음

싸이닉솔루션은 2025년 기준 220여 개 팹리스 기업들을 고객사로 보유하고 있다. 주요 고객은 대만 폭스콘 계열사인 Fitipower, 대만 GMT, 대만 Holtek, 대만 ANPEC, 대만 Leadtrend, 중국 BYD, 중국 BOE의 관계사 ESWIN, 중국 halo microelectronics 등이다. 파운드리(위탁생산) 파트너사로는 SK하이닉스시스템IC, SK파운드리, PSMC, UMC, SK파워텍 등이 있다.

이 외에 프랑스 차량용 칩 설계기업 Cortus, 벨기에 반도체 연구기관 imec, 대만 임베디드 메모리 IP(지적재산권) 기업 eMemory 등도 동사 고객이며, 근적외선 센서, 전력반도체 사업을 확장해 나간다면 미국 Stratio, 미국 Elevation 등 미주 팹리스들도 향후 고객으로 추가될 전망이다.

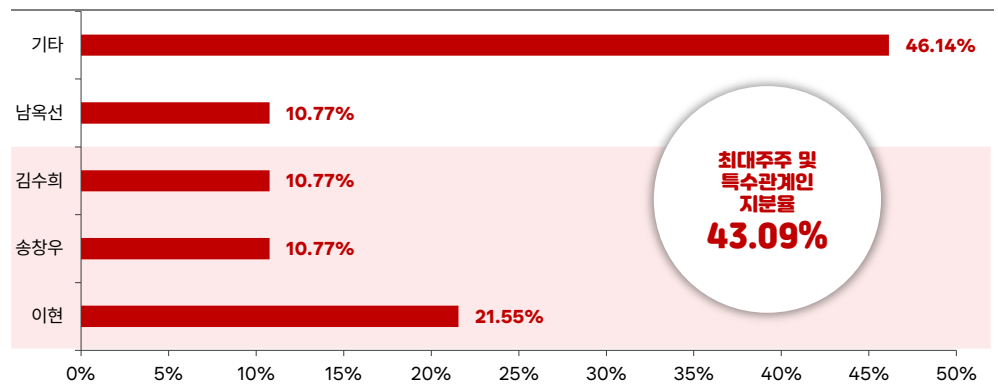
㉠ 최대주주 등은 이현 대표이사 외 2인

**최대주주 등은 이현 대표이사 외
2인으로 지분율 43.09% 보유**

싸이닉솔루션 최대주주는 이현 대표이사로, 싸이닉솔루션 지분 21.55%를 보유하고 있다. 최대주주 등은 이현 대표이사 외 2인으로, 지분율은 43.09%이다(2025년말 사업보고서 기준).

이현 대표이사는 고려대학교 전자공학과 출신으로 1967년생이다. 舊 현대전자(現 SK하이닉스)에서 1994 ~ 2000년 기간 동안 근무를 한 이후 2000년부터 (주)자람테크놀로지에서 대표이사를, 2005년 이후 (주)토파니디자인 대표이사직을 맡은 바 있다. 그는 2005년 舊 현대전자(現 SK하이닉스) 출신 인력들과 함께 싸이닉솔루션을 창업했고, 설립 이후 현재까지 대표이사직을 지속적으로 맡아오고 있다.

싸이닉솔루션 주주 현황(4Q25말 기준)



자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터



PMIC 정의 및 시장 현황/전망

**PMIC는 전력을 전자기기의
요구 전압에 맞게 변환 분배하고
이상 상태를 제어하는 반도체**

PMIC(Power Management IC, 전력관리반도체)는 전원에서 공급받은 전력을 전자기기 내부의 각 부품이 요구하는 전압과 전류로 변환·분배하고, 과전압·과전류·과열 등 이상 상태를 제어하는 반도체이다. 스마트폰과 PC, 가전, 자동차 및 산업기기 등 대부분의 전자기기에 탑재되며, 적용처에 따라 요구 전압과 기능이 달라 다품종 시장을 형성한다.

전압 변환과 고전압 제어가 필요한 PMIC에는 아날로그 회로와 제어 로직, 고전압 소자를 하나의 칩에 구현하는 BCD(Bipolar-CMOS-DMOS) 공정이 널리 사용된다. 아날로그 회로/고전압 소자는 공정 선폴을 줄이더라도 면적이 같은 비율로 감소하지 않아 첨단 로직 반도체보다 미세화에 따른 원가 절감 효과가 작고 생산라인을 변경할 경우 소자 특성에 맞춰 공정을 재설계하고 고객 인증도 받아야 한다. 이로 인해 일부 고집적 제품은 12인치 웨이퍼 공정을 활용하고 있으나, 대부분 PMIC와 전력소자는 8인치 웨이퍼 라인에서 생산되고 있다.

8인치 PMIC 제품 기초 수요는 대규모로 출하되는 스마트폰과 PC, 가전에서 발생한다. 메모리와 주요 부품 원가 상승으로 2026년 글로벌 스마트폰, 노트북 수요는 약세가 예상된다. 2026년 글로벌 스마트폰 출하량은 전년 대비 13.9%, 노트북 출하량은 13.6% 감소할 전망이다. 스마트폰, PC 수요 약세의 부담은 존재하나, 소비자 전자제품은 절대 출하량이 많아 여전히 8인치 PMIC 제품 수요 기반을 형성하고 있다. 2026년 초에는 주요 기업인 PC·노트북 세트업체들이 향후 8인치 생산능력 부족과 부품 가격 상승에 사전적으로 대비하기 위해 전력관리반도체 조달을 앞당겨 연초 8인치 웨이퍼 투입 증가를 야기하기도 했다.

소비자 전자제품 외에 AI 서버와 엣지 AI 기기용 전력관리반도체 및 전력소자 주문이 증가 추세에 있다. AI 서버의 연산량과 소비전력이 증가할수록 GPU와 메모리에 전력을 공급하는 PMIC와 전력 변환용 MOSFET 제품의 탑재량 및 요구 사양도 높아진다. AI 관련 주문 증가는 8인치 파운드리 공정 웨이퍼 투입량 증가로 이어진다. 글로벌 8인치 웨이퍼 시스템 반도체 수요는 소비자 전자제품용 PMIC가 기본 물량을 형성하는 가운데 AI 관련 제품이 추가적인 수요원으로 유입되는 구도이다.

글로벌 8인치 웨이퍼 파운드리 공정 수요가 유지되는 반면, 글로벌 8인치 웨이퍼 생산능력은 오히려 감소하고 있다. 대표적인 파운드리 기업인 TSMC와 삼성전자는 2025년 하반기부터 일부 8인치 웨이퍼 라인을 축소하거나 다른 용도로 전환하고 있으며, 선단 파운드리 투자는 첨단 공정과 첨단 패키징을 중심으로 이루어지고 있다. 이에 글로벌 8인치 웨이퍼 파운드리 생산능력은 2026년 전년 대비 2.4% 감소할 전망이다. SMIC와 뱅가드 등이 생산능력을 일부 늘리고 있으나, TSMC와 삼성전자의 축소분을 상쇄하기에는 부족한 수준이다.

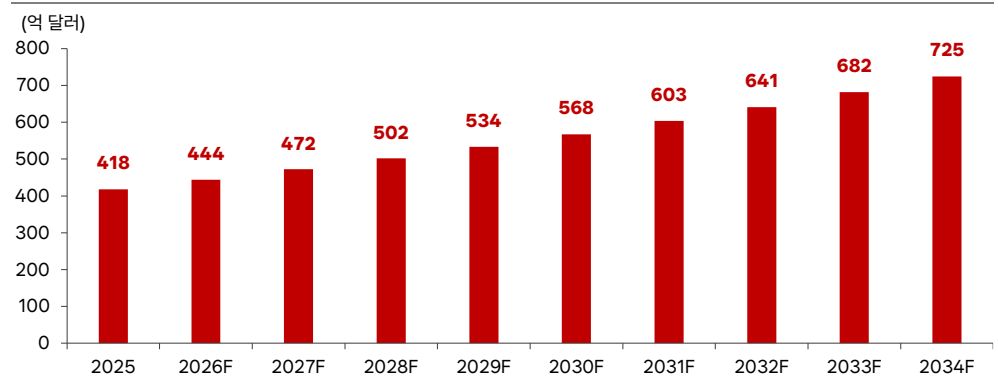
수요 유지 또는 일부 상승 대비 공급 축소가 발생하며 글로벌 상위 10개 파운드리 기업들의 8인치 웨이퍼 평균 가동률은 2025년 약 80%에서 2026년 상반기 약 88%로 상승했으며, 하반기에는 90% 내외에 이를 전망이다. 2026년 상반기 8인치 웨이퍼 파운드리 가격도 기존 대비 평균 5~15% 상승했다. 이에 따라 고객 입장에서는 필요한 물량을 안정적으로 확보할 수 있는 파운드리와의 연계가 중요해지고 있다.

글로벌 8인치 웨이퍼 수급 변화는 중국의 반도체 현지화와 맞물리고 있다. 중국 팹리스는 현지 생산을 전제로 PMIC 제품군 개발 및 판매를 확대하고 있으며, 중국 내 파운드리도 BCD와 고전압 CMOS 등 필요 제품 양산에 필요한 공정을 제공하고 있다. 2025년부터 AI 서버용 전력반도체 주문과 중국 내 반도체 현지화 수요가 함께 증가하면서 중국 파운드리 기업들의 BCD 및 PMIC 공정 가동률도 상승했다.

글로벌 상위 파운드리의 성숙공정 생산 축소는 중국 내 생산거점으로서의 주문 이동으로 이어지고 있다. 중국의 대표적 파운드리 SMIC 경영진은 2026년 1분기 실적 발표에서, 글로벌 파운드리의 가용 생산능력이 줄어들면서 일부 고객이 중국 내 파운드리로 주문을 이전하고 있다고 밝혔다. 중국 내 생산 기반은 자국 팹리스의 신규 제품뿐 아니라 해외에서 재배치되는 성숙공정 제품에도 대응하는 방향으로 변화되고 있다.

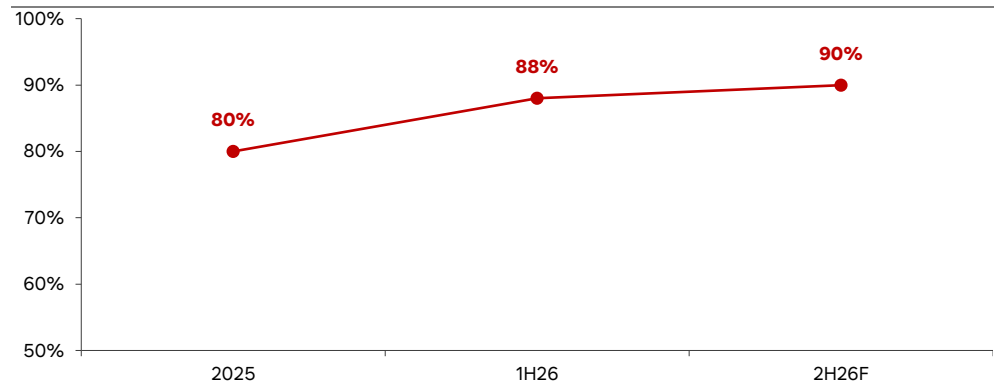
종합하면 PMIC 제품은 공정 전환에 따른 비용과 인증 등 부담으로 8인치 웨이퍼 생산 기반이 유지되는 가운데 글로벌 8인치 웨이퍼 생산능력은 감소하고 있다. 소비자 전자제품용 PMIC가 기본 물량을 형성하는 가운데 AI 관련 전력관리반도체 주문이 추가되고 있으며, 중국에서는 PMIC 현지화와 해외 성숙공정 주문 재배치가 함께 진행되고 있다. 이에 따라 중화권 팹리스 고객 및 중국 내 8인치 파운드리와 연계되어 있고, BCD·고전압 공정의 제품 개발과 양산 전환을 지원할 수 있는 업체에는 기존/신규 제품 개발 및 공급 요청 등 전반적인 사업 기회가 발생할 수 있다.

글로벌 PMIC 시장 규모 및 전망



자료: Fortune Business Insights, 한국IR협의회 기업리서치센터

상위 10개 파운드리 8인치 팹 평균 가동률



자료: TrendForce, 한국IR협의회 기업리서치센터

CIS 정의 및 시장 현황/전망

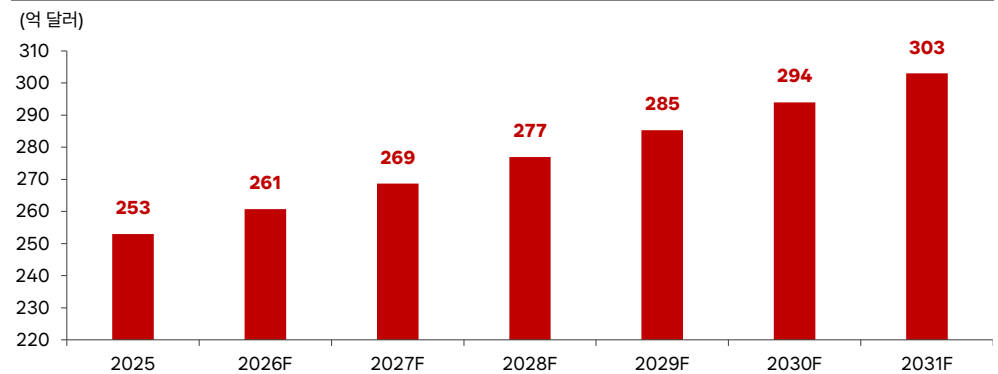
CIS는 영상 데이터를 생성하는 반도체로, 모바일·차량·보안용 수요 확대에 따라 시장 성장 전망

CIS(CMOS Image Sensor)는 렌즈를 통해 들어온 빛을 전기신호로 변환하여 영상 데이터를 생성하는 반도체이다. 픽셀 어레이의 포토다이오드가 빛을 전하로 변환하고, 판독·증폭 및 아날로그-디지털 변환 회로가 이를 영상 신호로 처리한다. 화소 수와 픽셀 크기뿐 아니라 감도와 노이즈, 광역 동적범위 및 저조도 성능 등이 제품 사양을 결정하므로, CIS 설계에서는 픽셀 설계와 아날로그-혼합신호 회로 설계가 함께 요구된다.

CIS 공정은 수광 효율과 집적도를 높이는 방향으로 발전해 왔다. 전면조사형(FSI) 공정 제품은 픽셀 위 배선층이 입사광 일부를 차단하지만, 후면조사형(BSI) 공정 제품은 배선층을 포토다이오드 뒤로 배치하여 수광 효율을 높인다. 이후 픽셀층과 로직층을 분리해 수직으로 결합하는 적층형 공정 제품이 도입되면서, 제한된 센서 면적에서도 화소 수와 신호처리 성능을 높일 수 있게 되었다.

스마트폰은 전·후면에 여러 개의 CIS가 탑재되는 최대 수요처이다. 자동차에서는 서라운드뷰, 운전자·탑승자 모니터링 시스템 등 ADAS(첨단운전자보조시스템)가 확대되면서 차량당 탑재 카메라 수가 증가하고 있다. 보안·감시 카메라 시장에서도 야간 식별과 역광 보정을 위한 저조도·광역 동적범위 성능이 중요해졌으며, 산업·의료기기 시장에서는 머신비전과 영상진단 장비별로 센서 크기와 촬영 속도, 인터페이스 요구가 세분화/고도화되고 있다. 이러한 수요 확대에 따라 글로벌 CIS 시장은 2025년 253억 달러에서 2031년 303억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 적용처별 제품 사양도 더욱 다양해질 것으로 예상되고 있다.

글로벌 CIS 시장 규모 및 전망



자료: Yole Group, 한국IR협회의 기업리서치센터

제품 사양에 따라 12인치 미세공정과 8인치 성숙공정으로 생산 기반 구분

CIS 제품 사양이 다변화되며 제조 공정도 세분화되는 추세이다. 프리미엄 모바일용 고화소·적층 CIS는 제한된 면적에서 화소 수와 감도를 함께 높여야 하므로, 12인치 웨이퍼와 미세 로직 공정 활용 니즈가 확대되고 있다. 반면 미세공정이나 적층 구조가 필요하지 않은 제품은 90~180㎜급 8인치 공정에서 생산된다. 8인치 웨이퍼 공정은 최신 공정이 적용된 12인치 웨이퍼 공정보다 기술 수준이 낮은 생산 방식이기보다 요구 성능과 요구 생산량, 개발비 및 양산기간을 고려하여 선택되는 양상이다. 검증된 8인치 웨이퍼 성숙공정으로 요구 사양을 충족할 수 있는 제품에서는 12인치 신규 공정을 적용하는 것보다 기존 8인치 플랫폼을 유지하는 편이 효율적이다.

CIS 산업 공급망은 제품을 기획·설계하는 CIS 공급사와 웨이퍼를 위탁생산하는 파운드리, 설계와 제조 공정을 연결하

는 디자인하우스, 광학·후공정 업체 및 CIS를 렌즈·액추에이터·필터 등 부품과 결합(조립)하는 카메라모듈 업체로 구성된다. CIS 공급사는 설계와 생산을 함께 수행하는 종합반도체기업과 생산을 외부 파운드리에 위탁하는 팹리스로 다시 구분된다. 디자인하우스는 팹리스가 설계한 제품을 파운드리 공정에 맞게 구현하고 시제품 제작과 공정 검증, 양산 이관 등을 지원한다.

CIS 산업 공급망 현황

구분	사업 형태 및 역할	주요 기업
CIS 공급사	제품 기획, 픽셀회로 설계 및 판매	소니(일본), 삼성전자, 옴니비전(중국), 스마트센스(중국), 갤럭시코어(중국), 온세미컨덕터(미국) 등
파운드리	CIS 웨이퍼 제조 및 광학 공정 수행	TSMC(대만), 삼성전자, UMC(대만), SMIC(중국), SK하이닉스시스템C, Nexchip(중국) 등
디자인하우스	공정 적용, 회로레이아웃 설계, 시제품 제작 및 양산 이관	싸이닉솔루션, Forza Silicon(미국), Caeleste(벨기에) 등
광학·구동부품	렌즈·광학필터·AF/OIS 액추에이터 등 생산	Largan Precision(대만), Sunny Optical(중국), Crystal-Optech(중국), Alps Alpine(일본) 등
패키징·테스트	CIS 웨이퍼레벨 패키징 및 전기·광학 검사	Xintec(대만), Tong Hsing(대만), ASE(대만), Amkor(미국) 등
카메라모듈	CIS와 렌즈·액추에이터·필터 조립	LG이노텍, Sunny Optical(중국), Foxconn(대만), 삼성전기, OFILM(중국) 등

자료: 산업자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

중국 공급사 확대로 중화권 고객
및 8인치 공정 대응력을 갖춘
업체에 개발·양산 기회 발생할
것으로 기대

글로벌 CIS 시장은 2025년 매출액 기준으로 일본 소니가 약 50%를 차지하고 있으며, 삼성전자와 옴니비전이 소니 뒤를 추격하고 있다. 프리미엄 모바일 영역에서는 픽셀 미세화와 적층 공정에 대규모 투자가 필요하여 상위 선도업체의 점유율이 높다. 반면, 모바일 보조카메라와 보안·감시, 자동차 및 AIoT 시장은 요구 사양과 가격대가 다양하여 여러 공급사들이 제품별로 경쟁하고 있다.

최근 옴니비전, 스마트센스, 갤럭시코어 등 중국계 공급사들의 CIS 제품이 확대되고 있다. 중국은 2025년 일본에 이어 세계 2위 CIS 공급 기반 국가로 올라섰다. 중국에는 Xiaomi와 OPPO, vivo 등 스마트폰 세트업체와 Hikvision, Dahua 등 보안·감시 업체, 다수 카메라모듈 업체들이 밀집해 있다. 중국 현지 CIS 공급사가 모바일에서 보안·감시, 자동차 및 AIoT로 제품 적용처를 넓혀가면서 제품 개발과 웨이퍼 생산, 모듈 조립 등을 연결하는 중국 내 밸류체인의 역할도 커지고 있다.

중국 CIS 공급사의 제품군 확대는 12인치와 8인치 웨이퍼 공정 수요를 함께 늘리고 있다. 고화소·적층형 제품은 12인치 웨이퍼 공정에서 신규 개발과 생산 확대가 이뤄지는 반면, 보안·감시와 IoT 및 모바일 보조카메라 등에 적용되는 성숙공정 제품은 기존 8인치 웨이퍼 플랫폼에서 개발·양산된다. 따라서 중국 CIS 공급사의 성장을 특정 웨이퍼 규모의 수요로 단순 해석하기보다 제품 사양에 따라 두 생산 기반이 함께 확대되는 흐름으로 볼 필요가 있다.

파운드리 기업들의 생산능력 재배치는 먼저 12인치 웨이퍼 성숙공정에서 나타나고 있다. 여러 대만 파운드리들이 90나노 이상 고전압·CIS 공정의 일부 생산능력을 전력반도체로 전환하고 파운드리 가격을 인상하면서, 안정적인 가격과 생산능력을 확보하려는 일부 CIS 고객들이 2025년 하반기부터 중국 파운드리로 이동했다. 해당 물량은 중국의 90나노 이상 12인치 웨이퍼 수요를 견인했으며, Nexchip 등 중국 파운드리 가동률 상승으로 이어졌다.

8인치 웨이퍼 공정에서는 고객과 모델별 요구 사양이 매우 다양한데, 양산기간이 긴 제품들을 중심으로 신규 개발과 장기 위탁생산이 이어지고 있다. 보안·감시와 IoT, 모바일 보조카메라용 CIS 제품이 대표적이다. 최근에는 8인치 웨이퍼 파운드리 생산능력 축소와 전력반도체 주문 증가로 인해 시장 수급이 타이트해지면서 8인치 웨이퍼 CIS 고객도 안정적인 생산능력과 장기 양산이 가능한 위탁생산 공정을 확보하는 것이 중요해지고 있다.

참고로 중국 내 파운드리 기업들은 웨이퍼 규격과 대응 제품에 따라 역할이 구분되는 경향이 있다. 중국 파운드리 1위 SMIC는 8인치와 12인치 웨이퍼 생산라인을 모두 확보하여 폭넓은 제품군에 대응하고 있으며, 3위권 파운드리 기업 Nexchip은 90나노 이상 12인치 웨이퍼 성숙공정을 중심으로 CIS 주문을 확보하고 있다. 한편 한국 파운드리 기업인 SK하이닉스시스템C 우시법인은 0.18마이크로미터부터 90나노까지의 8인치 웨이퍼 공정에 집중하고 있으며, 모바일과 보안·IoT용 CIS 공정 및 90나노 BSI 제품의 장기 양산 이력을 보유하고 있다.

외부 파운드리를 활용하는 CIS 업체는 제품 사양을 해당 파운드리 픽셀과 로직, 광학 공정에 맞게 구현해야 한다. 픽셀에서 발생한 신호를 처리하는 ROIC(적외선 이미징에서 신호 변환·처리 기능을 수행하는 칩)을 설계하고 시제품 제작과 특성 평가, 노이즈 및 수율 개선 등을 거쳐야 양산에 진입할 수 있다. 특히 8인치 웨이퍼 CIS는 이미 검증된 공정을 기반으로 고객별로 세부 맞춤형 제품을 개발하는 경우가 많아 기본 설계보다 제품 설계와 파운드리 공정을 연결하는 역량이 중요하다. 이에 중화권 CIS 고객과 8인치 파운드리 공정에 대응하고 FSI·BSI 공정 적용과 ROIC 설계, 시제품 제작 및 양산 이관을 적극 지원할 수 있는 업체에는 신규 제품 개발과 후속 양산에 따른 수요가 지속적으로 이어질 것으로 전망된다.

디자인하우스 정의 및 시장 현황/전망

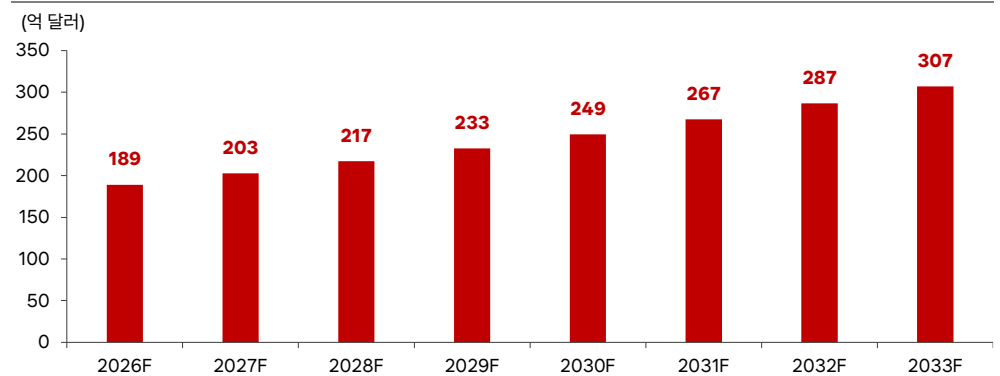
디자인하우스는 팹리스가 설계한 반도체를 특정 파운드리 공정에서 제조할 수 있는 형태로 구현

디자인하우스는 시스템 반도체 팹리스 기업이 설계한 반도체를 특정 파운드리 공정에서 제조할 수 있는 형태로 구현하고 양산까지 관리하는 사업자이다. 팹리스가 제품 사양과 아키텍처, 논리·아날로그 회로 등을 설계하면 디자인하우스는 이를 파운드리 공정설계키트와 설계 규칙에 맞춰 배치·배선한다. 이후 전력과 성능, 면적 및 제조 가능성 등을 검증하고 테이프아웃(설계를 완료해 파운드리 공장으로 도면을 넘기는 단계)을 진행한다. 계약 범위에 따라 웨이퍼 발주와 패키징·테스트까지 일괄 관리하는 툰키 서비스도 제공한다.

디자인하우스는 시스템 반도체 산업에서 설계와 제조가 분리되는 과정에서 형성되었다. 1987년 대만 TSMC 설립을 계기로 위탁제조만 담당하는 파운드리 사업모델이 등장하면서 자체 생산설비 없이 설계에만 집중하는 팹리스 기업들이 성장할 수 있는 기반이 마련되었다. 1990년대에는 컴퓨터 그래픽과 네트워크, 무선통신용 반도체 수요가 증가하며 미국 퀄컴과 브로드컴, 엔비디아 등 다수 팹리스가 성장했다. 그러나 파운드리마다 트랜지스터 구조와 배선 규칙, 전압 조건 및 생산 특성, 검증 절차가 달라 팹리스의 설계를 각 제조공정에 맞게 구현하는 역할이 필요했다. 이를 담당하기 위해 디자인하우스가 등장했으며, 현재까지도 주요 파운드리의 파트너 생태계를 중심으로 디자인하우스 시장이 형성되어 있다.

과거 디자인하우스는 배치·배선과 공정 최적화 등 백엔드 물리 구현을 주로 담당했다. 최근에는 AI와 클라우드 기업의 맞춤형 ASIC 수요가 늘어나면서 일부 사업자가 팹리스 고객 요구 사양의 구체화와 논리 설계, IP 통합까지 서비스 범위를 넓히고 있다. 자체 아키텍처 설계 조직을 보유한 하이퍼스케일러는 물리 구현과 IP 통합, 패키징 및 양산관리만을 외부에 맡기는 반면, 내부 설계조직이 부족한 고객은 요구 사양 구체화부터 논리 설계와 양산까지 더 넓은 범위를 외주화하는 경향을 보이고 있다. 맞춤형 ASIC 수요와 설계 외주 범위가 함께 확대되면서 글로벌 ASIC 디자인서비스 시장은 2026년 189억 달러에서 2033년 307억 달러로 연평균 7.2% 성장할 전망이다(시장조사기관 Persistence Market Research).

글로벌 ASIC 디자인서비스 시장 규모 및 전망



자료: Persistence Market Research, 한국IR협회의 기업리서치센터

**디자인하우스의 매출은 고마진
개발과 외형이 큰 양산으로
구분되며 양산 전환이 실적의 핵심**

디자인하우스 매출은 프로젝트 진행 단계에 따라 개발 매출과 양산 매출로 구분된다. 개발 매출은 고객의 사양과 아키텍처를 제조 가능한 설계로 구현하는 과정에서 발생한다. 논리 설계와 물리 구현, IP 통합, 검증 및 테이프아웃 등이 포함되며, 통상 NRE(초기개발비)와 설계 단계의 IP 매출로 인식된다. 엔지니어 인건비와 IP·마스크 비용 등도 투입되지만 대규모 양산 웨이퍼 매입원가는 발생하지 않아 일반적으로 양산 매출보다 마진이 높은 경향이 있다. 다만 동일 과제에서는 개발기간에 한해 발생하는 프로젝트성 매출이다.

개발된 반도체는 테이프아웃 이후 파운드리가 제작한 초도 실리콘(시스템 반도체 제품)의 기능·성능 검증과 고객 인증 등을 거쳐 대량양산에 진입한다. 턴키 방식에서는 디자인하우스가 웨이퍼와 패키징·테스트를 진행하여 고객에게 공급하며, 관련 비용이 매출과 원가에 총액으로 반영된다. 이에 따라 양산 매출은 제품 생산기간 동안 반복적으로 발생하여 개발 매출보다 외형이 커질 수 있지만 매출총이익률은 상대적으로 낮다.

개발 매출과 양산 매출은 서로 대체되는 매출원이 아니라 하나의 프로젝트가 진행될 때 구현되는 연속된 단계이다. 신규 개발 수주와 수주잔고는 향후 개발 매출로 이어질 파이프라인을, 테이프아웃은 설계가 완료되어 제조 단계로 넘어갔음을 나타낸다. 다만 실제 양산 주문은 초도 실리콘 검증과 고객 인증 이후에 발생하므로, 인증 진행 상황과 양산 전환 건수를 함께 살펴봐야 한다. 양산 제품·고객 수와 고객별 매출 비중은 기존 프로젝트에서 발생하는 반복 매출의 기반을 형성한다. 결국 신규 개발 과제가 지속적으로 유입되는 가운데 기존 과제가 문제없이 양산으로 전환되는지가 디자인하우스 실적 확대의 핵심 요소이다.

디자인하우스 프로젝트 진행 단계

구분	① 개발	② 양산 전환	③ 양산
진행 과정	논리·물리 설계 IP 통합·검증	테이프아웃 → 초도 실리콘 검증 → 고객 인증	웨이퍼 발주 패키징·테스트
발생 매출	NRE·IP 매출	-	턴키·제품 매출
매출 특성	프로젝트성 상대적 고마진	-	생산기간 동안 반복 큰 외형·상대적 저마진
핵심 지표	신규 개발 수주 수주잔고	인증 진행 상황 양산 전환 건수	양산 제품·고객 수 고객별 매출 비중

자료: 산업자료, 한국IR협회의 기업리서치센터

**글로벌 1위 디자인하우스 GUC는
턴키 매출 비중 상승이 지속되는
추세. 이익률은 하락했으나 이익
규모는 증가**

이와 같은 매출 구조는 대만 GUC(글로벌유니칩) 사례에서 확인된다. 대만 GUC는 1998년 설립되어 2006년 대만 증시에 상장한 글로벌 1위 디자인하우스로, 글로벌 파운드리 기업 TSMC가 최대주주로서 GUC 지분 35%를 보유하고 있다. TSMC는 GUC의 유일한 파운드리 공급사이기도 하다.

GUC의 2Q26 매출은 138.96억 대만달러로 전년 동기 대비 약 128% 증가했다. NRE·IP 매출은 23.1억 대만달러로 11% 늘었고, 턴키 매출은 115.86억 대만달러로 188% 증가했다. 이에 따라 턴키 매출 비중은 83.4%까지 상승했다.

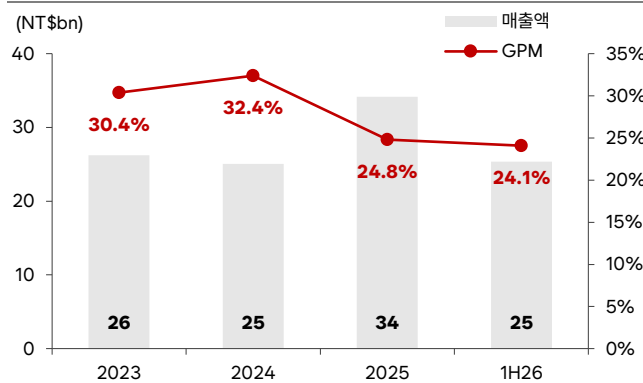
GUC의 연간 턴키 매출 비중은 2022년 70%, 2023년 72%, 2024년 65%, 2025년 75%를 각각 기록했다. 2Q26에는 기존 클라우드 ASIC 프로젝트가 대규모 양산 단계로 넘어가면서 턴키 매출이 외형 성장을 견인했다. 같은 기간 NRE·IP 매출도 증가하여 기존 프로젝트의 양산 전환과 개발 파이프라인 유지가 동시에 나타났다고 볼 수 있다.

공정과 응용처별 구성에서 고부가제품 확대가 확인된다. 2Q26 매출의 75%가 7나노 이하 공정에서 발생했고 3나노 이하 비중도 51%에 달했다. 턴키 매출에서는 3나노 이하 비중이 59%였으며, 응용처별로는 클라우드가 전체 매출의 79%를 차지했다. 과거 진행한 클라우드용 CPU와 AI 가속기 프로젝트가 선단공정 양산으로 전환된 결과이다.

GUC의 2Q26 매출총이익률은 21.5%로 1Q26의 27.2%와 2Q25의 33.3%를 하회했다. 턴키 매출에 총액으로 반영되는 웨이퍼와 패키징·테스트 비용이 증가했고, NRE와 턴키 부문 내 제품 구성도 변화한 영향이다. 다만, 매출총이익은 약 29.9억 대만달러로 전년 동기 약 20.3억 대만달러보다 47% 증가했다. 양산 규모 확대가 이익률 하락폭을 상회하면서 이익 절대액은 증가했다.

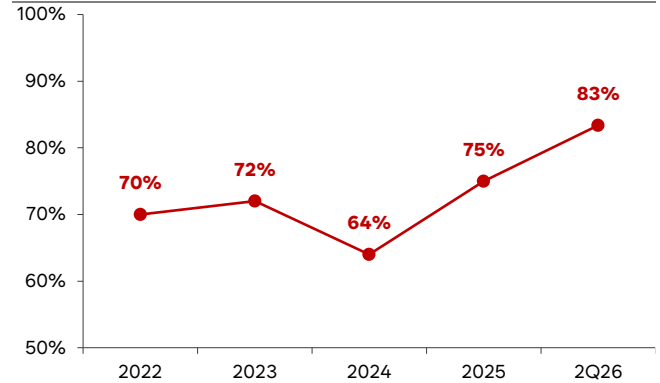
GUC 사례는 개발 매출이 유지되는 가운데 기존 프로젝트가 양산으로 전환될 경우, 매출총이익률이 낮아져도 양산 규모 확대를 통해 이익 절대액은 증가할 수 있음을 보여준다. 따라서 디자인하우스의 실적은 이익률뿐 아니라 개발 파이프라인과 양산 전환, 이익 절대액의 변화가 함께 고려되어야 한다.

GUC 매출액 및 GPM 추이



자료: GUC, 한국IR협의회 기업리서치센터

GUC 턴키 매출 비중 추이



자료: GUC, 한국IR협의회 기업리서치센터

**국내 디자인하우스는 대응 공정에
따라 서로 다른 사업 구조 형성.
8인치 공정 수요 회복 국면 진입에
따라 해당 양산 기반을 갖춘
업체의 반복 매출 확대 기대**

국내 디자인하우스도 주요 파운드리 생태계와 대응 공정 등에 따라 사업 구조가 달라진다. 삼성전자 디자인하우스로는 가온칩스, 에이디테크놀로지, 코아시아, 세미파이버 등이 참여하고 있으며, 에이직랜드는 국내에서 유일한 TSMC VCA(Value Chain Alliance)이다. 싸이닉솔루션은 SK하이닉스시스템IC의 공식 디자인 파트너로, 8인치 성숙공정 ASIC을 중심으로 사업을 전개하고 있다.

삼성전자와 TSMC 생태계 산하의 국내 디자인하우스들은 선단공정 ASIC 프로젝트를 확대하고 있다. 선단공정은 회로 집적도와 설계 복잡도가 높아 대규모 엔지니어 조직과 장기간의 검증이 필요하고, 공정용 IP와 마스크 비용도 높아 프

로젝트당 개발 규모가 크다. 이에 따라 개발·용역 매출이 먼저 인식되고, 양산 매출은 테이프아웃과 고객 인증을 거친 뒤 시차를 두고 발생한다.

반면 8인치 웨이퍼 성숙공정 중심 디자인하우스는 상대적으로 짧은 개발주기와 낮은 프로젝트당 비용을 기반으로 다양한 고객향으로 다품종 ASIC 제품에 대응한다. 개별 프로젝트 개발 매출은 선단공정보다 작지만 다수의 제품이 양산 단계에 누적되면서 반복적으로 인식되는 양산 제품 매출 비중이 높아진다. 웨이퍼 비용이 매출과 원가에 함께 반영되므로 매출총이익률은 낮게 나타날 수 있다. 그러나 양산 기반이 여러 고객과 제품으로 분산돼 있어 특정 대형 프로젝트의 양산 전환 시점에 대한 의존도가 낮고, 기존 양산 제품의 반복 주문을 바탕으로 상대적으로 안정적인 실적 기반을 형성하는 경향을 보여준다. 현재 8인치 웨이퍼 성숙공정은 AI 관련 반도체 주문과 중국의 현지 조달 확대, 고객사의 재고 보충에 힘입어 수요 회복 국면에 진입한 상태이다. 디자인하우스의 양산 매출은 팹리스 고객의 웨이퍼 주문량에 연동되므로, 이러한 수요 회복은 기존 양산 제품의 반복 주문 증가로 이어진다. 다수 고객과 양산 제품을 확보한 디자인하우스 사업자는 이에 더해 신규 개발 제품을 양산에 추가하여 반복 매출 기반을 넓힐 수도 있다.

싸이닉솔루션은 SK하이닉스시스템IC의 공식 디자인 파트너로서 8인치 웨이퍼 성숙공정 사업 경험을 오랜 기간 축적했고 220개 이상의 팹리스 고객과 2025년 매출의 약 92%를 차지하는 제품 매출 기반을 확보했다. 여기에 여러 신규 제품의 개발과 양산도 준비하고 있다. 이에 따라 싸이닉솔루션은 8인치 성숙공정 파운드리 수요 회복으로 인한 기존 양산 매출 증가 및 신규 제품의 양산 전환으로 인한 중장기 매출 기반 확대 등으로 본격적인 외형 성장 국면에 진입 가능할 것으로 기대된다.

투자포인트

1 신성장동력 신제품(센서 3종)을 통한 중장기적 성장 기대

센서 3종(MEMS 마이크로폰-초음파-SWIR) 개발로 중장기 성장동력 확보

싸이닉솔루션은 기존 제품과 다른 신성장동력을 통한 성장성 확보를 계획하고 있다. 당사는 다양한 센서 제품 개발 (Development)과 양산(Mass Production)을 수행할 능력을 보유하고 있다. 구체적으로 당사는 1) 팹리스의 설계 및 공정에 적합한 설비를 보유한 파운드리 기업을 발굴하여 협업 중이고, 2) 각 팹리스의 공정을 파트너 파운드리 공정을 고려하여 최적의 Friendly Process로 변경할 수 있으며, 3) 필요시 파트너 파운드리가 미보유한 Special Process의 지원을 위한 전문업체 발굴 및 공정 지원도 가능하다.

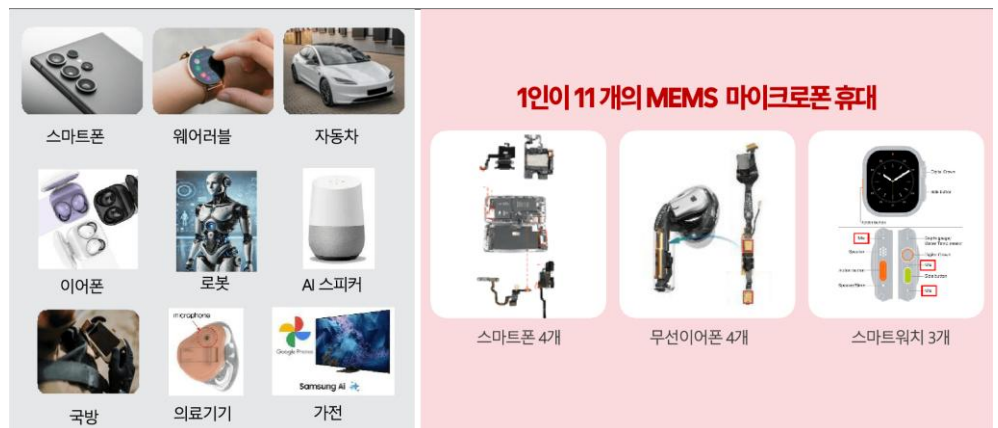
주요 신제품인 MEMS 마이크로폰 센서 등 센서 3종을 이르면 2H27부터 매출할 것으로 기대한다. 신제품 센서 3종을 알아보면 다음과 같다.

MEMS 마이크로폰 센서는 저전력·고성능 음성인식용으로 소형화 구현

1) MEMS 마이크로폰 센서

MEMS는 Micro Electro-Mechanical System의 약어로, 미세 전자기계 시스템을 의미한다. 매우 작은 기계적/전기적 구성 요소를 첨단 반도체 기술을 이용, 단일칩에 통합하는 기술이다. MEMS 마이크로폰 센서는 저전력 고성능 음성인식 센서로서, 당사는 MEMS 기술을 적용하여 제품의 고성능 및 소형화를 동시에 구현할 예정이다. 주요 적용 어플리케이션에는 스마트폰, 웨어러블 기기, 스마트카, 이어폰, 로봇 등이 있다. 아래 그림에서 살펴볼 수 있듯 통상 소비자 1인이 11개의 MEMS 마이크로폰 센서를 휴대하는 만큼, 동 제품의 사업성은 매력적이라고 보인다.

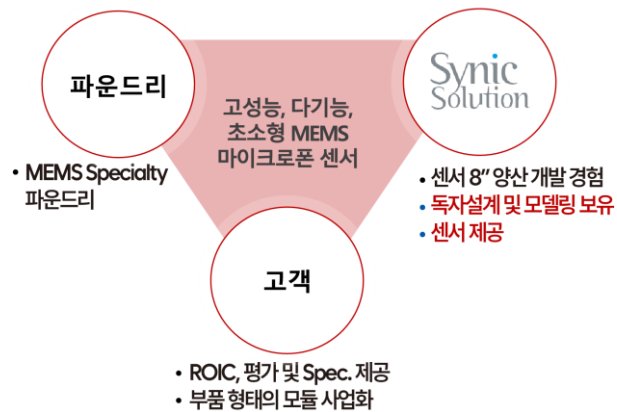
MEMS 마이크로폰 센서 주요 적용 어플리케이션 분야, 어플리케이션당 3~4개 탑재



자료: 싸이닉솔루션, 한국IR협회의 기업리서치센터

싸이닉솔루션은 MEMS 분야 위탁생산 기술력을 보유한 SK하이닉스시스템IC와 오랫동안 동 제품의 상용화를 위해 준비를 진행하고 있다. 현재 일부 개발 완료한 시제품은 잠재 고객들에게 프로모션 중이다. MEMS 마이크로폰 센서 제품의 응용 분야는 다양하나, 사업 초기에는 무선 이어폰용 제품 탑재/진입을 우선 목표로 하고 있다. 관련 제품의 초도 양산 시점은 1Q27일 것으로 전망되고, 본격적인 매출 발생은 2027년 하반기일 것으로 예상된다.

MEMS 마이크로폰 센서 개발 및 양산 에코시스템 구축



자료: 싸이닉솔루션, 한국R협회의 기업리서치센터

실리콘 소재 기반 의료기기용

초음파 센서 개발 진행

2) 초음파 센서(Ultrasonic Sensor)

의료기기용 초음파 센서는 인체 내부 구조를 관찰하거나 진단에 활용하기 위해 고주파 음파를 송신 및 수신하는 장치이다. 의료용 초음파는 방사선을 사용하지 않아 비교적 안전하며, 산부인과·내과·응급의학 등에서 널리 쓰이는 진단 장비의 핵심 구성요소이다.

싸이닉솔루션이 개발 중인 실리콘 소재 기반 초음파 센서는 1% 이하의 오차율로 정확한 측정이 가능하고, MEMS 기술을 응용하여 고성능, 소형화, 저전력, 저비용을 구현할 수 있으며, 기존 제품들이 납(Pb) 소재를 쓰는 데에 반해 실리콘 소재를 이용하는 만큼 친환경 구현이 가능하다. 동사가 채택한 초음파 센서 개발 방식은 CMUT(Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer)로, CMUT는 미세 진동막과 하부 기판 사이의 정전용량 변화를 활용하여 초음파를 송수신하는 기술이다. 기존 압전 방식보다 반도체 제조공정과 연계하기 용이해 집적화 및 다양한 응용 가능성을 확보할 수 있다는 것이 특징이다. 싸이닉솔루션은 CMUT 기술을 의료용 3D·4D 초음파 진단과 내시경 초음파, 피부 부착형 생체 모니터링을 비롯해 차량·로봇의 장애물 감지와 제스처 인식 등에 활용 가능한 센서 플랫폼으로 개발하고 있다. 8인치 반도체 파운드리와 공동으로 전용 제조공정을 구축하고 있으며, 첫 번째 CMUT 제품에서 우수한 전기적 특성을 확보했다. 향후 의료용 초음파 진단 제품을 중심으로 실장 평가와 제품 인증을 진행하여 2027년 하반기 양산에 돌입할 것으로 기대된다. 제품 주요 적용 어플리케이션으로 의료기기, VR 헤드셋, 비파괴 검사 장비, 드론, 전기차 등이 가능하다.

동사 초음파 센서 개발 방식 CMUT과 기존 개발 방식 PMUT 비교

비교 항목	CMUT	PMUT
작동 원리	정전용량방식	압전방식
주요 소재	Silicon	PZT, AlN, ZnO
주파수 특성	넓은 대역폭, 고주파대응	상대적으로 좁은 진폭
출력	높은 출력 구현 가능	제품 구조에 따라 제한
반도체 공정 연계	MEMS·CMOS 공정과 연계 용이	압전소재 증착과의 공정 호환성 필요
구동 전압	높음	낮음
주요 난제	높은 구동 전압, Special 공정(진공 본딩 등)	소재(Pb)에 따른 환경 규제, 출력 특성, CMOS 호환성

자료: 싸이닉솔루션, 한국R협회의 기업리서치센터

**SWIR 센서는 약천후 식별과
비파괴 검사 등으로 적용처 확대
기대**

3) 적외선 센서(SWIR 센서)

SWIR(Short-Wave Infrared, 단파장 적외선) 센서는 적외선 스펙트럼 중 0.9um~2.5um 대역 파장을 감지하는 센서이다. SWIR은 가시광선보다 길고, 중파장 적외선(MWIR)보다는 짧은 영역이다. SWIR 센서는 약천후나 안개가 강한 환경 내에서의 식별이나 실리콘 투시, 비파괴 물성 확인 및 마약 감지 등에 쓰인다. 주요 적용 어플리케이션은 스마트카, 반도체 검사, 국방용 드론, 가전제품, 로봇 등이다.

SWIR 센서

주요 적용 어플리케이션



자율주행, ADAS



반도체검사 공정

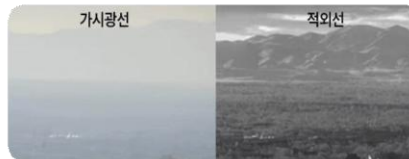


국방, 드론

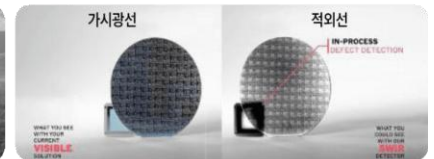


가전, 로봇

SWIR 센서 사용 예시



약천후 및 안개 비전



실리콘 투시



비파괴 물성 확인



의약품 또는 마약 감지

자료: 싸이닉솔루션, 한국IR협회의 기업리서치센터

싸이닉솔루션은 Ge(게르마늄)-on-Si 기반 SWIR 센서 원천기술을 보유한 미국 STRATIO, INC.(스트라티오)와 협력하여 관련 제품의 반도체 설계와 개발, 양산 체계 구축을 준비 중이다. 전통적인 SWIR 센서는 고가의 화합물반도체를 사용하여 국방과 산업용 등 일부 니치 시장을 중심으로 적용되어 왔다. 일본 Sony의 화합물반도체 기반 적외선 센서는 판매가격이 약 2만 달러로 매우 비싼 편이다. 반면, Ge-on-Si 기술은 실리콘 반도체 생산공정과의 호환성이 높으므로 대량 양산 체계를 구축할 시 제품 가격 경쟁력을 높일 수 있다는 장점이 있어 당사는 Ge-on-Si 기반 SWIR 센서 양산을 계획하고 있다.

화합물반도체 SWIR VS Ge SWIR(싸이닉솔루션, 스트라티오)

구분	InGaAs SWIR	Ge SWIR(싸이닉솔루션, 스트라티오)
01. 공정 가능 웨이퍼 크기	최대 4인치	최대 12인치
02. 제작 공정 난이도	복잡	단순, 양산에 적합
03. 양산 비용	Ge 대비 10배~20배	InGaAs 대비 1/10~1/20 수준
04. 파장 비교	1,700nm	1,600nm (InGaAs와 유사 수준)

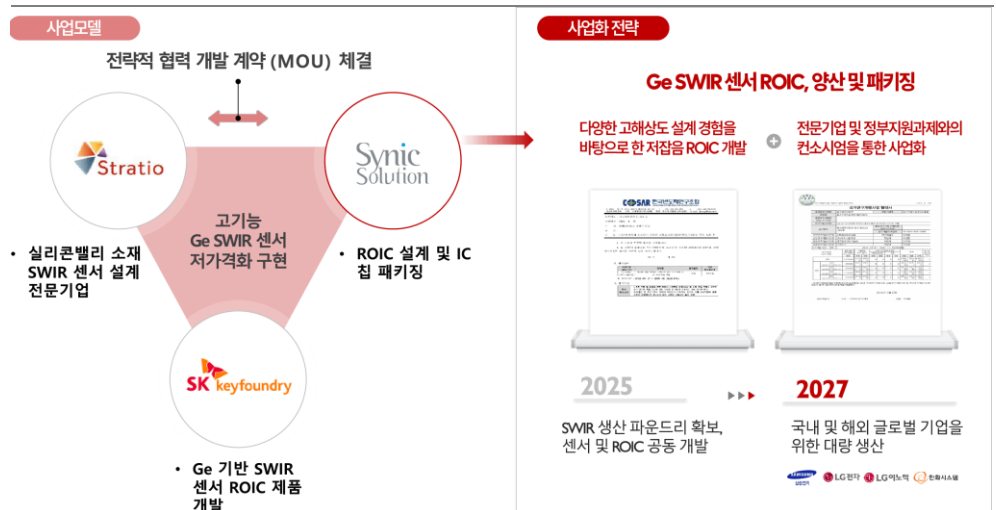
자료: 싸이닉솔루션, 한국IR협회의 기업리서치센터

**스트라티오·SK파운드리와 3사
협력으로 Ge SWIR 센서 사업화,
매출은 2027년 하반기 예상**

스트라티오는 Ge-on-Si SWIR 센서의 설계 전문기업이고, 동사의 경우 ROIC(Read-Out Integrated Circuit, 신호 판독 집적회로) 설계 및 IC칩 패키징 기술을 확보하고 있으며, SK파운드리는 전력반도체 등 분야에 특화된 위탁생산 전문기업으로 Ge 기반 SWIR 센서 양산이 가능하다. 스트라티오, 동사, SK파운드리 3사는 Ge SWIR 센서 양산을 위해 전략적 협력 개발 계약을 체결하고, 함께 사업화를 진행 중이다. SWIR 기술은 물질별로 서로 다른 광학 특성을 분석할 수 있어 반도체 검사와 식품/소재 판별, 머신비전 등에 다양하게 활용 가능하다. 가시광으로 확인하기 어려운

정보를 검출할 수 있다는 특성 때문에 향후 국방, 보안, 드론, 각종 산업 모니터링 등 시장으로 적용/응용 분야가 확대 될 수 있을 것으로 기대된다.

싸이닉솔루션 Ge SWIR 센서 사업모델, 사업화 전략



자료: 싸이닉솔루션, 한국IR협회의 기업리서치센터

적외선 센서 제품은 크게 이미지 센서, 스펙트럴 센서 2가지로 제품이 준비될 예정이다. 이미지 센서는 스마트카, 드론, 반도체 장비, 가전, 로봇에 채용되어 약천후 시 시야 식별, 자율주행 기능 향상, 크랙 등 구분 등에 활용될 전망이고, 스펙트럴 센서의 경우 섬유재질 혹은 플라스틱 구분, 마약류 탐지, 과일 당도 측정 등에 사용될 전망이다. 현재 개발 중인 스펙트럴 센서는 모잠재 대형 국내 고객과 실장 평가도 이미 진행 중이어서 긍정적이다. SWIR 제품들의 본격적인 매출 시기는 2027년 하반기로 예상된다.

종합적으로 볼 때 싸이닉솔루션은 신제품 센서 3종 개발 및 양산 준비를 통해 기존 제품 집중도를 완화하고 전사 성장성을 높이며, 신규 고객을 추가적으로 발굴할 수 있을 것으로 기대된다.

現 주력 제품(PMIC, CIS)의 안정적인 성장

220개 이상 팹리스 고객
기반으로 PMIC-CIS의
안정적 성장 지속 기대

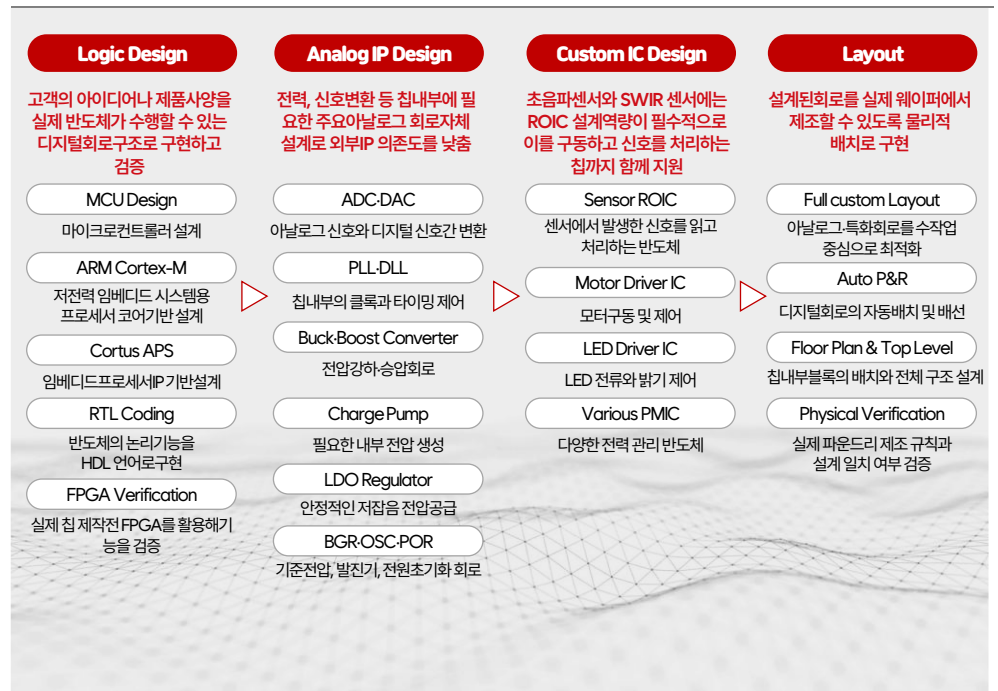
現 주력 제품인 PMIC(Power Management IC), CIS(시모스 이미지 센서) 제품의 안정적인 성장이 향후 지속될 것으로 기대된다.

싸이닉솔루션은 220개 이상의 반도체 팹리스 고객을 확보하여 PMIC, CIS 등 제품을 활발히 공급 중이다. 팹리스 고객은 통상 전공정 회로 설계에 집중하여 파운드리 공정에 대한 이해도가 다소 부족하다. 또한, 일부 후공정 설계나 필요 IP 구성/최적화 작업 등에 전문성이 높지 않다. 그리고 팹리스들은 양산 효율성을 고려하지 않은 기능 위주의 복잡하고 난해한 SoC(System on Chip) 개발을 강행하기도 한다.

디자인하우스인 동사는 팹리스가 설계한 회로를 실제 반도체 제조에 적합하게 재구현한다. 구체적으로 칩 스펙 사전 설계 및 재설계, 필요 IP 확보, 제품화 및 패키지 설계 등을 수행한다. 한편, 파운드리 업체들의 니즈도 적절히 반영하여

제품 개발을 이끌게 된다. 각 파운드리 업체들은 제조 공정상 개별 특성이 존재하는 만큼, 이를 설계단에서도 사전에 고려해야 한다. 또한, 파운드리 업체 입장에서 살펴볼 때 수많은 팹리스 기업들의 서로 다른 니즈 관련 대응이 쉽지 않은데, 동사가 이러한 팹리스-파운드리 상호간 요청/니즈를 적절히 조율한다. 따라서 동사는 수많은 팹리스 고객들은 물론 SK하이닉스시스템C, SK파운드리 등 파운드리 기업들의 호평도 얻고 있다. SK하이닉스시스템C 관련 디자인하우스는 동사가 유일하다는 점이 동사의 높은 기술력 및 영업력/대응력에 대한 방증이라 볼 수 있다.

팹리스와 파운드리 간 가교 역할을 하는 디자인하우스, 싸이닉솔루션



자료: 싸이닉솔루션, 한국IR협회의 기업리서치센터

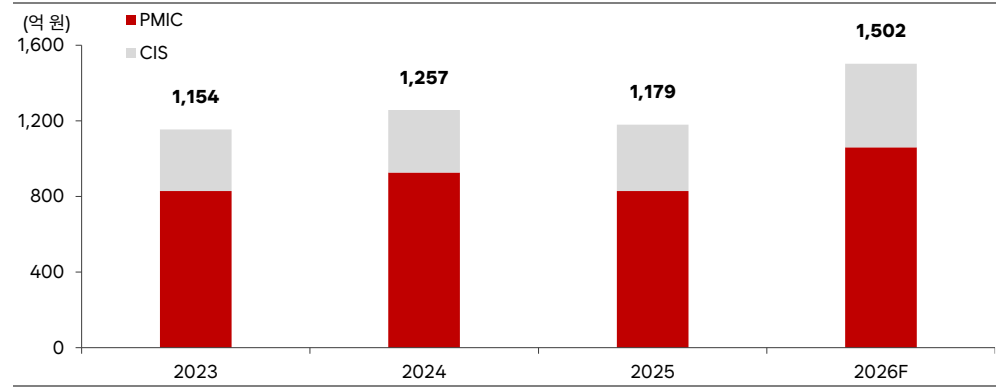
PMIC(Power Management IC) 제품 수요는 꾸준히 성장하고 있다. 주요 성장 동인은 전기차 시장의 성장, 5G 통신 네트워크의 확대, 공장 자동화/스마트 그리드 활성화 등이다. 즉 다양한 산업에서 전력을 관리하고 효율을 높이려는 니즈가 확대되며 PMIC 수요도 늘고 있는 것이다. 싸이닉솔루션은 중국/대만 팹리스 고객을 대상으로 130nm, 180nm 공정 기반의 PMIC 제품을 제공하며, 점차 고전압/전장용 제품으로 라인업을 확장 중이다. PMIC는 동사 핵심 사업으로, 연구개발을 지속 중이며 장기적으로는 GaN, SiC 기반 차세대 Power IC 공정도 개발 중이다.

CIS(CMOS Image Sensor) 제품 수요도 꾸준하다. CIS는 사물을 전기적 영상신호로 변환하는 센서 반도체로, 스마트폰 등 모바일 기기 핵심 부품이며 VR, 자율주행 등 신성장 기술에서도 다각도로 활용된다. 고성능 CIS는 삼성전자와 소니가 주도하며, 일반 팹리스 업체들은 8인치 파운드리에서 중저가형 또는 비모바일 CIS를 생산하는 상황이다. SK하이닉스시스템C는 8인치 파운드리 기업 중 유일하게 90nm BSI 공정 기반 CIS 제품 대량 양산이 가능하며, 픽셀 맞춤 개발 기술을 바탕으로 다양한 팹리스의 CIS 제품 생산을 지원하고 있다. 동사는 SK하이닉스시스템C와 동반하여 중화권 CIS 수요에 대응하고 있다.

**신제품 센서가 기여하기 전까지
PMIC-CIS가 캐시카우 역할 담당**

연도별 동사의 PMIC + CIS 매출액 추이 및 전망은 아래와 같다. PMIC, CIS 제품은 안정적 성장이 기대된다. 앞서 언급된 신제품 센서 3종이 동사 실적에 의미 있게 기여하기 전까지 PMIC, CIS 매출은 캐시카우 역할을 담당할 것으로 예상된다.

PMIC + CIS 매출액 추이 및 전망



자료: 싸이닉솔루션, 한국IR협회의 기업리서치센터



실적 추이 및 전망

2025년 실적 review

2025년 매출액
1,546억 원(-7.7% YoY),
영업이익 25억 원(-52.3% YoY)
기록

2025년 연간 연결 기준 매출액, 영업이익은 각각 1,546억 원, 25억 원이었다.

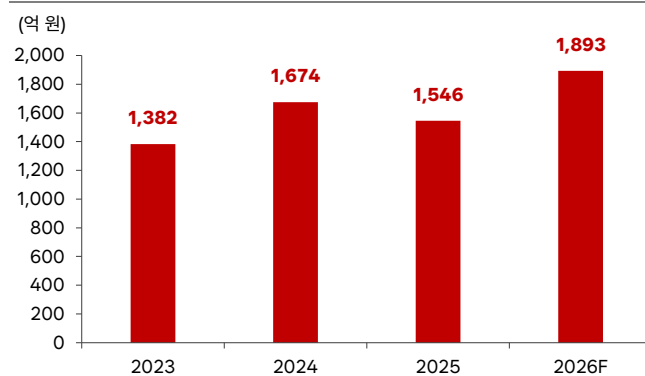
연간 매출액은 전년(1,674억 원) 대비 7.7% 역성장한 1,546억 원을 기록했다. 이는 BYD 계열사향 매출액이 수요 감소 등으로 인해 전년 대비 약 200억 원 감소한 점, 전년 모 중국 팹리스의 이미지센서 설계 용역 증가 이후 소멸에 따른 기저효과에 주로 기인했다.

제품별로 보면 다음과 같았다. ASIC - PMIC 매출액은 2024년 926억 원에서 2025년 828억 원으로 10.6% 감소했다. BYD 계열사 영향 등을 받은 것으로 보인다. 반면 ASIC - CIS 매출액은 2024년 331억 원에서 2025년 351억 원으로 6.0% 증가했다. 중화권 전반에서 CIS 수요는 2024년 주춤한 이후 2025년 다소 반등한 것으로 파악된다. ASIC - DDI 매출액은 2024년 217억 원에서 2025년 153억 원으로 29.6% 감소했다. DDI 관련 고객들의 전반적인 주문 감소가 있었다. ASIC - 기타 매출액은 2024년 25억 원에서 2025년 78억 원으로 급증했다. ASIC - 기타 매출의 경우 연도별로 수치 회복은 크나 그 규모는 크지 않음을 주지해야 한다. ASSP(Application Specific Standard Product) 매출액은 2025년 7억 원으로 전년(7억 원) 수준이었다. ASSP 제품의 경우 동사 자체 제품으로 해당 제품은 IR receiver IC와 Payment IC 제품 등이다. ASSP 제품들은 판매가 쉽게 늘기는 어려운 측면이 있어 동 매출 레벨에 머물고 있는 상황이다. 마지막으로 개발용역 외 제품과 Display, 기타 매출 합계는 2024년 168억 원에서 2025년 128억 원으로 40억 원 감소했다. 전반적인 수요 약세 영향이 있었던 것으로 보인다.

연간 영업이익은 전년(53억 원) 대비 52.3% 감소한 25억 원을 기록했다. 전년 대비 매출액이 7.7% 역성장한 요인과 마진이 좋은 이미지센서 설계 용역 소멸, 상장비용 등이 부정적인 영향을 미쳤다. 전사 영업이익률은 2024년 3.1%에서 2025년 1.6%로 1.5%p 악화되었다.

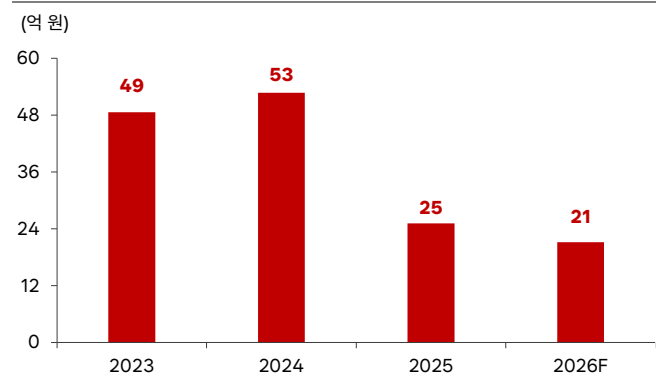
참고로 2025년 매출원가율, 판관비율은 각각 92.0%, 6.3%를 보여 2024년 대비 매출원가율은 0.2%p 개선되고, 판관비율은 1.6%p 악화되었다. 2024년 매출원가율, 판관비율은 각각 92.2%, 4.7%였다. 절대금액으로 보면, 매출원가의 경우 2024년 1,544억 원에서 2025년 1,423억 원으로 121억 원 감소했고, 판관비의 경우 2024년 78억 원에서 2025년 97억 원으로 19억 원 증가하는 수준을 보였다. 즉 매출원가의 경우 전년 대비 매출액 감소에 따라 동반하여 감소했고, 판관비의 경우 전년 대비 인건비, 경상연구개발비, 대손상각비 등 증가로 인해 증가세를 보였다.

연간 연결 기준 매출액 추이 및 전망



자료: 싸이닉솔루션, 한국IR협회의 기업리서치센터

연간 연결 기준 영업이익 추이 및 전망



자료: 싸이닉솔루션, 한국IR협회의 기업리서치센터

2026F 실적 전망

**2026년 연간 매출액, 영업이익은
각각 1,893억 원(+22.5% YoY),
21억 원(-15.9% YoY)으로 예상**

2026년 연간 매출액, 영업이익은 각각 1,893억 원(+22.5% YoY), 21억 원(-15.9% YoY)으로 예상된다.

2026년 연간 매출액을 제품별로 보면, ASIC - PMIC 매출액은 전년 대비 28.0% 증가한 1,060억 원으로 전망된다. 중국/대만 팹리스들의 주문이 전반적으로 강한 점을 고려했다. 2025년에 시장 내 제품들의 재고가 많이 소진된 것으로 보인다. ASIC - CIS 매출액은 전년 대비 26.0% 증가한 442억 원으로 예상된다. 고객들의 재고 축적 활동으로 중화권 수요가 전반적으로 강한 점을 역시 고려하였다. ASIC - DDI 매출액은 전년 대비 10.0% 증가한 168억 원으로 전망한다. 앞서 언급한 PMIC, CIS 제품 대비 수요 강도는 제한적일 것으로 보여 이를 반영했다. 이밖에 ASIC - 기타와 ASSP, 개발용역 외 제품/Display/기타 매출액은 전년 대비 각각 8.0%, 5.0%, 1.5% 성장한 84억 원, 8억 원, 130억 원으로 전망하였다. 주력 제품 대비 수요 증가세가 상대적으로 강하지는 못할 것으로 예상되어 이를 반영했다. 종합적으로 싸이닉솔루션 실적을 전망해 볼 때, 2026년에는 기존 주력인 PMIC, CIS 제품 위주로 수요 강세가 기대된다고 볼 수 있다.

2026년 연간 영업이익은 전년 대비 15.9% 감소한 21억 원으로 전망하였다. 전년 대비 전사 매출액 성장이 뚜렷함에도 직원 상여와 직원수 증가에 따른 인건비 상승, 신제품 준비에 따른 경장연구개발비 증가 부담 등이 상존하여 이를 종합적으로 고려했다. 즉 2026F 영업이익 추정에는 보수적 시각을 견지했다. 신제품 센서 3종이 본격적으로 동사 매출에 기여할 예상 시점인 2028년 이후에는 규모의 경제 효과와 개발비 감소 가능성 등으로 인해 의미 있는 수익성 개선을 기대해 볼 수 있다고 판단된다.

실적 추이 및 전망

(단위: 억 원)

구분	2023	2024	2025	2026F
매출액	1,382	1,674	1,546	1,893
① ASIC - PMIC	829	926	828	1,060
② ASIC - CIS	325	331	351	442
③ ASIC - DD(HV)	126	217	153	168
④ ASIC - 기타	6	25	78	84
⑤ ASSP	7	7	7	8
⑥ 개발용역 외 제품	82	158	120	122
⑦ Display	2	9	1	1
⑧ 기타(수수료수입 외)	6	1	7	7
영업이익	49	53	25	21
지배주주순이익	16	55	17	40
YoY 증감률				
매출액		21.1	-7.7	22.5
영업이익		8.4	-52.3	-15.9
지배주주순이익		247.4	-68.8	135.3
영업이익률	3.5	3.1	1.6	1.1
지배주주순이익률	1.2	3.3	1.1	2.1

자료: 싸이닉솔루션, 한국IR협의회 기업리서치센터



Valuation

2026F PER 18.1배로 거래 중

2026F PER 18.1배로 코스닥 시장 대비 할인되어 거래 중

2026년 8월 26일 기준 싸이닉솔루션 시가총액은 726억 원 수준이다. 2026년 싸이닉솔루션의 예상 PER은 18.1배 정도로, 코스닥 시장(23.2배) 대비 할인되어 거래되고 있다.

Peer로 에이디테크놀로지, 에이직랜드 선정

싸이닉솔루션은 시스템 반도체 생태계 내에서 중추적 역할을 담당하는 전문 디자인하우스이다. 동사와 유사한 상장 기업에는 에이디테크놀로지, 에이직랜드, 가온칩스, 코아시아, 세미파이브 등이 있다. 동사의 Peer로 에이디테크놀로지, 에이직랜드를 선정하여 아래 표와 같이 동사와 밸류에이션을 비교해 보았다(가온칩스와 코아시아는 컨센서스 부재, 세미파이브의 경우 컨센서스 부재 및 영업적자 지속 등 요인으로 Peer에서 제외).

2026년 비교 3개사의 PER 밸류에이션은 다음과 같다(동사 PER 18.1배 VS 에이디테크놀로지 PER 49.1배 VS 에이직랜드 PER 38.8배).

에이디테크놀로지는 삼성전자 파운드리 DSP로, 선단공정 특화 디자인하우스이다. 2026년 통신장비용 14nm SoC 양산을 시작으로 2027년에는 북미 서버용 CPU 4nm, 유럽 데이터센터용 가속기 4nm, 국내 Automotive용 BMS 등으로 양산 고객사가 확대될 전망이다. 다만 관련 이익 기여는 2027년 이후에 집중될 것으로 추정되는 바, 높은 2026F PER은 이익 기반이 아직 얇은 구간에서 향후 성장 기대가 선반영된 결과인 것으로 보인다.

에이직랜드는 국내 유일의 TSMC VCA(Value Chain Alliance)로, AI 및 메모리 컨트롤러 분야에서 선단공정 프로젝트를 수행하는 디자인하우스이다. 2Q26 분기 흑자전환에 성공했고, SK하이닉스 eSSD 컨트롤러 개발 계약금액이 410억 원으로 증액되며(2025년 매출액의 56.2% 비중) 개발 매출이 빠르게 확대되고 있다. 다만, 이익의 원천이 개발에서 양산으로 이동하며 손익 레버리지가 발생하는 시점은 2027년 하반기 이후로 전망되는 바, 높은 2026F PER은 양산 매출 확대에 따른 이익 개선 기대가 선반영된 것으로 판단된다.

동사가 Peer 대비 밸류에이션 할인을 받는 것은 선단공정·AI 대형 프로젝트 노출도가 상대적으로 낮고, 준비 중인 센서 신제품들이 확정 수주가 아닌 개발·프로모션 단계에 있어 가시성이 낮다는 점 등에 기인하는 것으로 보인다. 따라서 밸류에이션 갭은 센서 신제품들의 고객사·수주 계약 확정과 이에 따른 양산 매출 및 이익 규모 확대가 실적으로 확인될 시점 전후에 의미 있게 축소될 수 있을 것으로 예상된다.

동종 업종 밸류에이션

기업명	종가 (원, 달러)	시가총액 (십억원, 백만달러)	매출액(십억원, 백만달러)			PER(배)			PBR(배)		
			2024	2025	2026F	2024	2025	2026F	2024	2025	2026F
코스피	6,808	5,434,647	3,713,280	3,919,857	4,123,034	11.3	15.5	6.6	0.8	1.3	1.6
코스닥	827	462,323	332,974	361,554	137,678	210.6	112.9	23.2	1.5	2.1	2.8
싸이닉솔루션	3,075	73	167	155	189	-	111.9	18.1	-	5.7	1.8
에이디테크놀로지	25,900	349	107	165	238	N/A	126.1	49.1	1.6	3.2	2.4
에이직랜드	21,300	233	94	73	182	N/A	N/A	38.8	4.4	5.6	3.8
동종업종 평균						N/A	-	43.9	3.0	4.4	3.1

주: 1) 2026년 08월 26일 종가 기준, 2) 동사 외 26F는 시장 컨센서스 사용, 자료: FnGuide QuantWise, Refinitiv, 한국IR협의회 기업리서치센터

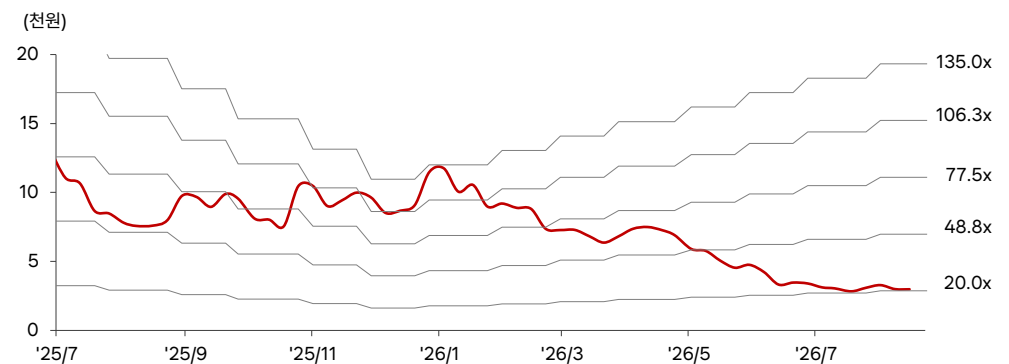
**PMIC-CIS의 안정적인 성장과
신제품 센서 3종의 고객 확보 및
양산 일정이 확인된다면 시장의
관심도는 상승 가능할 것으로 예상**

싸이닉솔루션은 2025년 7월 7일 코스닥 시장에 상장했다. 공모가는 4,700원이었는데, 시장의 높은 관심으로 상장일인 7월 7일 종가는 7,960원에 마감했다. 이후 2025년 연말(12월 30일) 종가는 8,850원이었다. 시스템 반도체 산업 및 동사에 대한 기대감이 이어지는 모습이었다.

2026년 초 이후 4월 말경까지 싸이닉솔루션 주가는 하락했으나, 그 정도가 심하지는 않았다. 동사 주가는 2026년 연초 이후 4월 30일(당시 주가 7,270원)까지 17.8% 하락했다. 싸이닉솔루션 주가의 큰 하락은 5월 초부터 7월 말까지의 기간에 이어졌다. 동사 주가는 5월 4일 종가 기준 7,380원에서 7월 31일 종가 기준 2,840원까지 해당 기간에 61.5% 급락했다. 이는 동기간 전반적인 반도체 업종 주가 급락 추세와 동행한 것으로 해석한다. 1) 1Q26 매출액, 영업이익이 각각 404억 원, 0억 원으로, 전년 동기 수치(매출액 314억 원, 영업이익 6억 원) 대비 수익성에서 부진했으나 매출은 오히려 성장한 점, 2) 2Q26 매출액, 영업이익이 각각 500억 원, 8억 원을 기록(VS 2Q25 매출액, 영업이익 각각 383억 원, 12억 원)하는 등 매출액 성장이 완연한 점을 볼 때 5~7월 기간 주가 급락은 다소 과도했다고 판단된다. PER 밴드상으로도 상장 이후 대체로 50~100배 수준의 멀티플에서 거래됐으나, 현재 주가는 밴드 최하단 수준까지 낮아진 상황으로 추가적인 하락은 제한적일 것으로 보인다.

향후 기존 주력 제품인 PMIC-CIS의 안정적 성장에 기반한 수익성 회복과, 신성장동력인 신제품 센서 3종(MEMS 마이크로폰·초음파·SWIR 센서)의 고객 확보 및 양산 일정 확인이 함께 확인된다면, 동사에 대한 시장의 관심도는 상승할 수 있다고 예상된다.

싸이닉솔루션 PER 밴드



자료: Quantwise, 한국IR협의회 기업리서치센터

⚠️ 리스크 요인

1 DSP 업계의 전반적으로 낮은 수익성

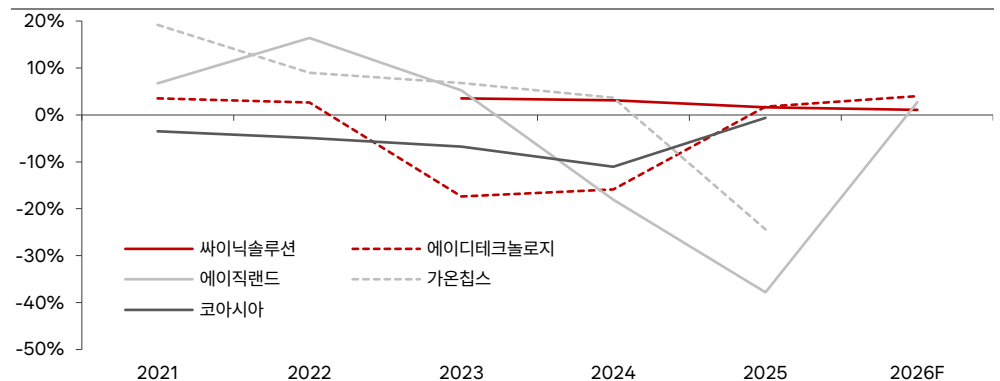
DSP 업계 전반의 수익성은 낮으나, 동사는 2018년 이후 영업흑자 유지

시스템 반도체 內 DSP(디자인솔루션파트너) 업체들은 아직 낮은 수익성(영업이익률)을 보이고 있다. 대한민국의 시스템 반도체 산업 생태계는 규모와 기술력, 기업 재무상태 등 측면에서 상대적으로 메모리 반도체 산업 대비 열위인 상태이다. 균형 발전 측면에서 한국의 반도체 산업 內 메모리 반도체 쏠림은 중장기적으로 볼 때 그리 바람직한 산업 방향성이라 보기는 어렵다. 국가 정책적 측면과 기업 자체적 노력 등으로 시스템 반도체 산업 생태계를 좀 더 튼튼히 키우는 노력이 필요하다.

싸이닉솔루션의 경우 DSP 경쟁사들 대비 상대적으로 수익성이 양호하다(아래 그래프 참고). 다수 경쟁사들은 영업적자와 흑자를 넘나드는 모습을 보이고 있는 반면, 동사는 2018년 이후 지속적으로 영업흑자를 기록 중이다.

비록 동사가 영업이익 흑자를 지속 시현하고는 있으나, 타 산업/기업 대비하여 이를 높은 마진이라 보기는 어렵다. DSP 업계 기업들이 수익성을 한 단계 높이려면 전략적으로 다각도의 많은 노력이 필요해 보인다. 싸이닉솔루션은 전술한 바와 같이 센서 신제품 3종 개발을 통해 이전과 다른 성장을 준비하고 있는 만큼, 향후 매출 규모 성장 및 이에 따른 수익성 상승 가능성은 존재한다. 이의 실현 가능 여부를 투자자들은 지속적으로 관찰해야 한다.

국내 주요 DSP 기업 영업이익률 추이 및 전망



주: 1) 싸이닉솔루션 26F는 동사 추정치 사용, 2) 에이디테크놀로지, 에이직랜드 26F는 시장 컨센서스 사용, 3) 가온칩스, 코아시아는 26F 실적 컨센서스 부재
자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

포괄손익계산서

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액	N/A	1,382	1,674	1,546	1,893
증가율(%)	N/A	N/A	21.1	-7.7	22.5
매출원가	N/A	1,278	1,544	1,423	1,750
매출원가율(%)	N/A	92.5	92.2	92.0	92.4
매출총이익	N/A	104	131	123	143
매출이익률(%)	N/A	7.5	7.8	7.9	7.6
판매관리비	N/A	56	78	97	122
판매비율(%)	N/A	4.1	4.7	6.3	6.4
EBITDA	N/A	53	57	28	28
EBITDA 이익률(%)	N/A	3.8	3.4	1.8	1.5
증가율(%)	N/A	N/A	7.1	-50.2	-0.3
영업이익	N/A	49	53	25	21
영업이익률(%)	N/A	3.5	3.1	1.6	1.1
증가율(%)	N/A	N/A	8.4	-52.3	-15.9
영업외손익	N/A	-21	20	-5	26
금융수익	N/A	27	39	24	44
금융비용	N/A	45	20	27	17
기타영업외손익	N/A	-3	0	-2	-1
총속/관계기업관련손익	N/A	0	0	0	0
세전계속사업이익	N/A	28	72	20	47
증가율(%)	N/A	N/A	160.5	-72.8	139.2
법인세비용	N/A	11	17	2	6
계속사업이익	N/A	16	55	18	41
중단사업이익	N/A	0	0	0	0
당기순이익	N/A	16	55	18	41
당기순이익률(%)	N/A	1.2	3.3	1.1	2.2
증가율(%)	N/A	N/A	237.8	-67.9	132.3
지배주주지분 순이익	N/A	16	55	17	40

현금흐름표

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
영업활동으로인한현금흐름	N/A	44	7	-24	90
당기순이익	N/A	16	55	18	41
유형자산 상각비	N/A	2	3	2	4
무형자산 상각비	N/A	2	1	1	3
외환손익	N/A	3	2	2	0
운전자본의감소(증가)	N/A	3	-64	-46	44
기타	N/A	18	10	-1	-2
투자활동으로인한현금흐름	N/A	-58	11	-161	-36
투자자산의 감소(증가)	N/A	-26	14	-155	-2
유형자산의 감소	N/A	0	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	N/A	-21	-1	-0	-24
기타	N/A	-11	-2	-6	-10
재무활동으로인한현금흐름	N/A	9	34	164	4
차입금의 증가(감소)	N/A	10	34	0	4
사채의증가(감소)	N/A	0	0	0	0
자본의 증가	N/A	0	0	163	0
배당금	N/A	0	0	0	0
기타	N/A	-1	0	1	0
기타현금흐름	N/A	-0	11	2	30
현금의증가(감소)	N/A	-6	63	-18	88
기초현금	N/A	150	144	208	189
기말현금	N/A	144	208	189	277

재무상태표

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
유동자산	N/A	341	411	566	671
현금성자산	N/A	144	208	189	277
단기투자자산	N/A	13	15	173	145
매출채권	N/A	94	117	116	142
재고자산	N/A	18	11	11	14
기타유동자산	N/A	72	60	75	92
비유동자산	N/A	91	71	72	101
유형자산	N/A	39	39	37	57
무형자산	N/A	5	4	3	11
투자자산	N/A	29	18	22	24
기타비유동자산	N/A	18	10	10	9
자산총계	N/A	433	482	637	772
유동부채	N/A	235	242	241	325
단기차입금	N/A	30	105	110	110
매입채무	N/A	37	28	23	28
기타유동부채	N/A	168	109	108	187
비유동부채	N/A	69	47	31	41
사채	N/A	0	0	0	0
장기차입금	N/A	41	31	20	28
기타비유동부채	N/A	28	16	11	13
부채총계	N/A	304	289	272	366
자배주주지분	N/A	127	191	365	406
자본금	N/A	2	20	24	24
자본잉여금	N/A	148	130	285	285
자본조정 등	N/A	-0	-0	-0	-0
기타포괄이익누계액	N/A	-8	-5	-5	-5
이익잉여금	N/A	-14	46	61	101
자본총계	N/A	129	193	365	407

주요투자지표

	2022	2023	2024	2025	2026F
P/E(배)	N/A	N/A	N/A	111.9	18.1
P/B(배)	N/A	N/A	N/A	5.7	1.8
P/S(배)	N/A	N/A	N/A	1.2	0.4
EV/EBITDA(배)	N/A	N/A	N/A	66.5	16.1
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
EPS(원)	N/A	96	277	79	170
BPS(원)	N/A	637	956	1,548	1,718
SPS(원)	N/A	8,347	8,371	7,081	8,020
DPS(원)	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROE	N/A	12.5	34.7	6.2	10.4
ROA	N/A	3.8	12.1	3.2	5.8
ROIC	N/A	N/A	61.3	20.5	15.8
안정성(%)					
유동비율	N/A	145.4	169.6	234.6	206.6
부채비율	N/A	236.3	150.2	74.4	89.9
순차입금비율	N/A	-37.9	-41.2	-60.2	-67.8
이자보상배율	N/A	8.5	10.4	5.5	4.6
활동성(%)					
총자산회전율	N/A	3.2	3.7	2.8	2.7
매출채권회전율	N/A	14.7	15.8	13.2	14.7
재고자산회전율	N/A	76.1	115.7	138.7	148.1

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.
※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
싸이닉솔루션	O	X	X

2026년 8월 5일 기준 특정계좌(군) 매매관여 과다, 소수계좌 거래집중 종목에 따른 투자주의종목으로 지정된 바 있음.

발간 History

발간일	제목
2026.08.28	싸이닉솔루션 - 꾸준히 성장하는 시스템 반도체 디자인하우스

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 기재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(<https://t.me/kirsofficial>)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '小中한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '小中한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.